

---

# 南亞電路板股份有限公司 2026年第一季營運概況

2026年6月12日



## 免責聲明

---

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



# 議程

---

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 2026年營運策略



# 公司概況

## 事業簡述

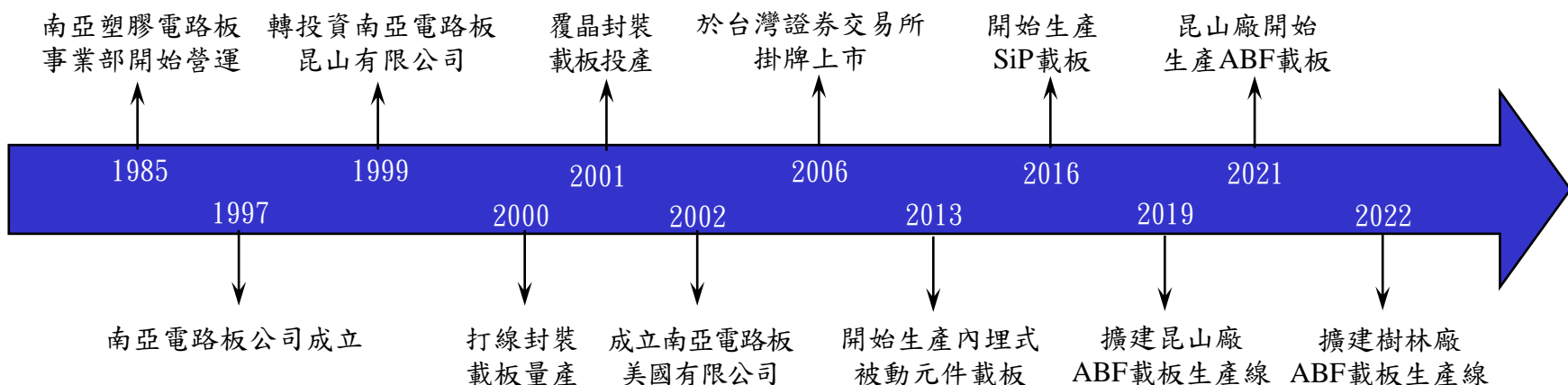
---

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2026年第一季合併營業額為新台幣111.7億元
- 台股上市市值：新台幣3,373.0億元(2026年3月31日)
- 生產廠區：台灣、大陸



# 公司概況

## 歷史沿革



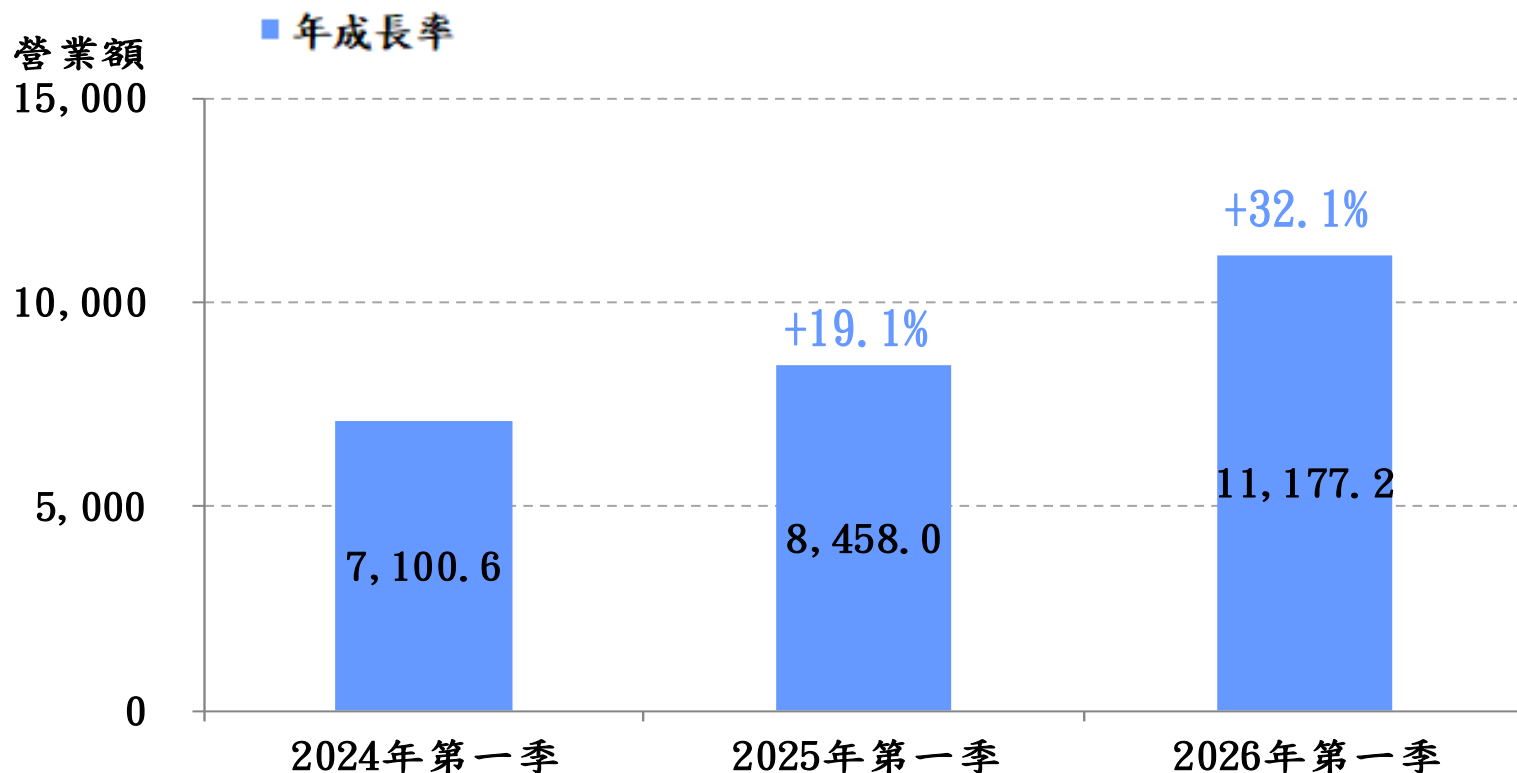
- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板
- 2022 : 樹林廠開始生產ABF載板



# 財務狀況

## 近三年合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元



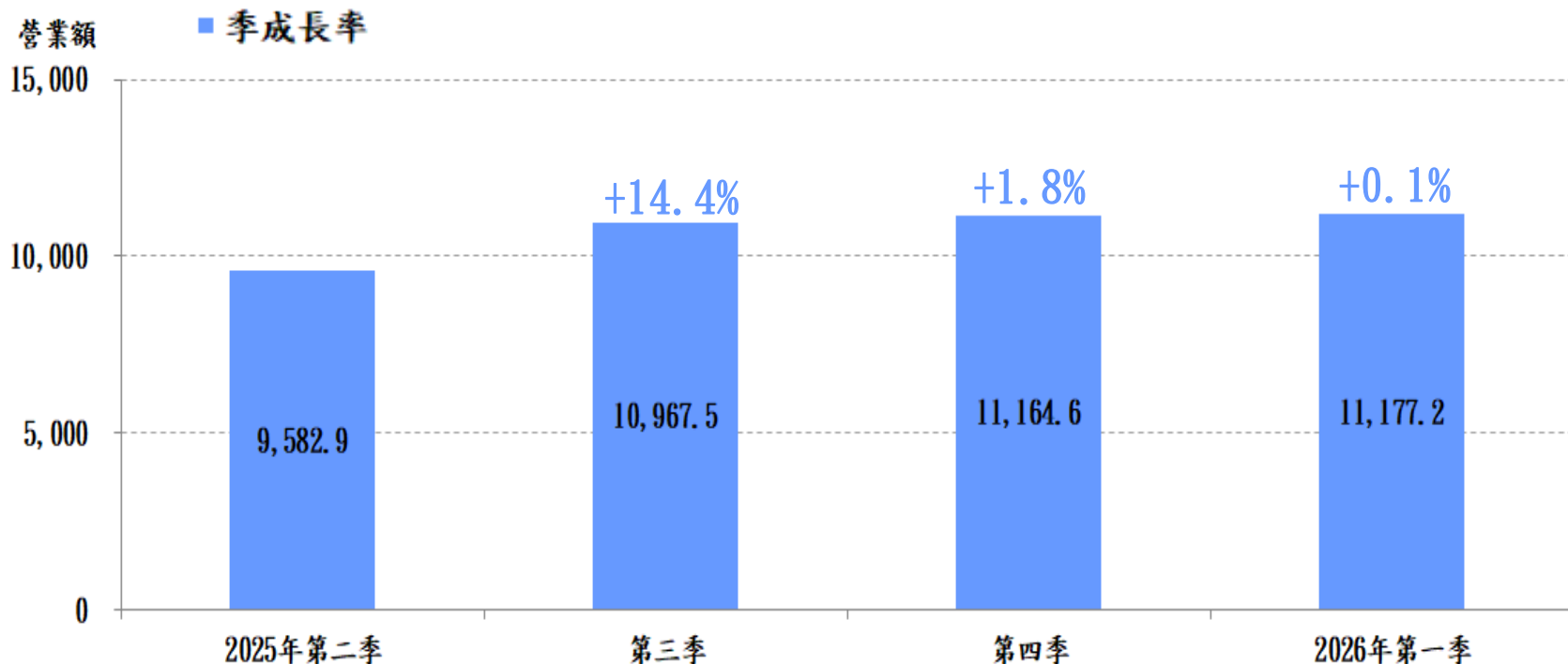
- 2025年第一季營收較2024年第一季增加19.1%:  
高階伺服器、800G交換器及企業級固態硬碟等應用IC載板需求增加，2025年第一季營收比2024年第一季成長。
- 2026年第一季營收較2025年第一季增加32.1%:  
受益於資料中心對伺服器與交換器需求持續提升，相關應用高階IC載板銷售增加，2026年第一季營收比2025年第一季再成長。



# 財務狀況

## 近一年每季合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

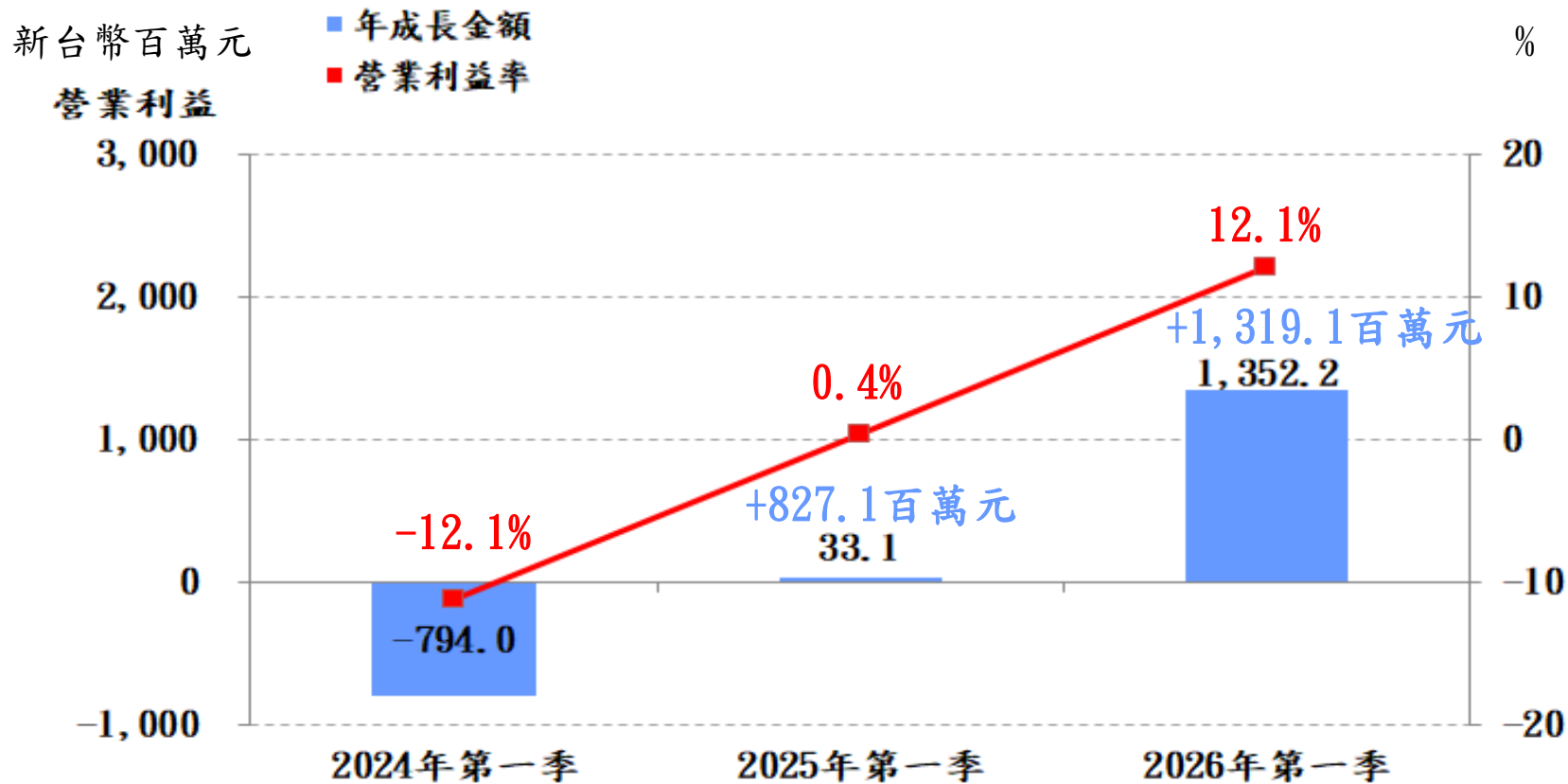


- 2025年第三季營收較2025年第二季增加14.4%:  
雲端應用產品穩健成長，記憶體需求復甦，第三季營收再提升。
- 2025年第四季營收較2025年第三季增加1.8%:  
高階伺服器、交換器需求提高，第四季營收比第三季增加。
- 2026年第一季營收較2025年第四季增加0.1%:  
高階IC載板需求強勁，抵銷工作天數減少影響，第一季營收優於第四季。



# 財務狀況

## 近三年營業利益

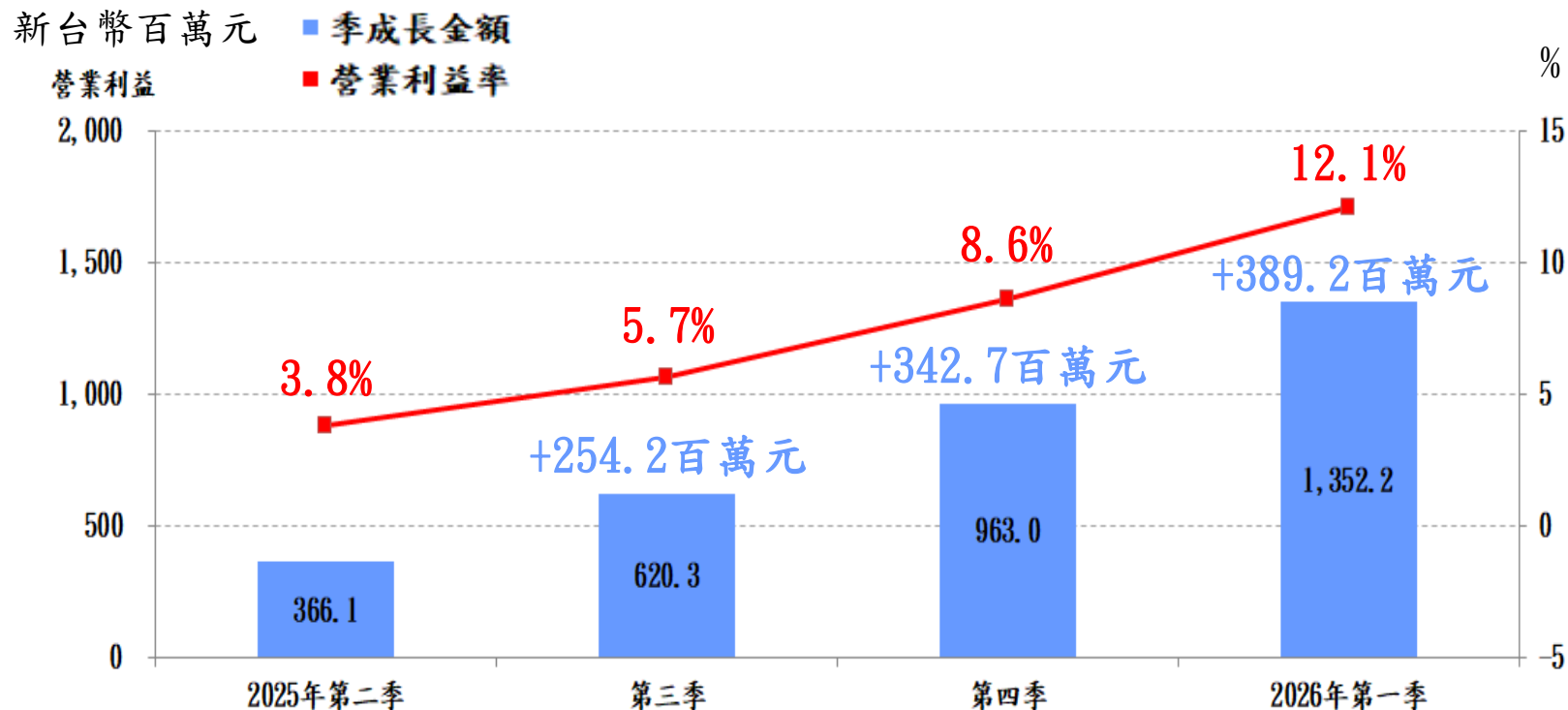


- 2025年第一季營業利益較2024年第一季增加827.1百萬元：  
高階網通應用產品需求提升，產品組合轉佳，致營業利益提高。
- 2026年第一季營業利益較2025年第一季增加1,319.1百萬元：  
伺服器、交換器及記憶體等高階應用產品需求提高，帶動營業利益成長。



# 財務狀況

## 近一年每季營業利益

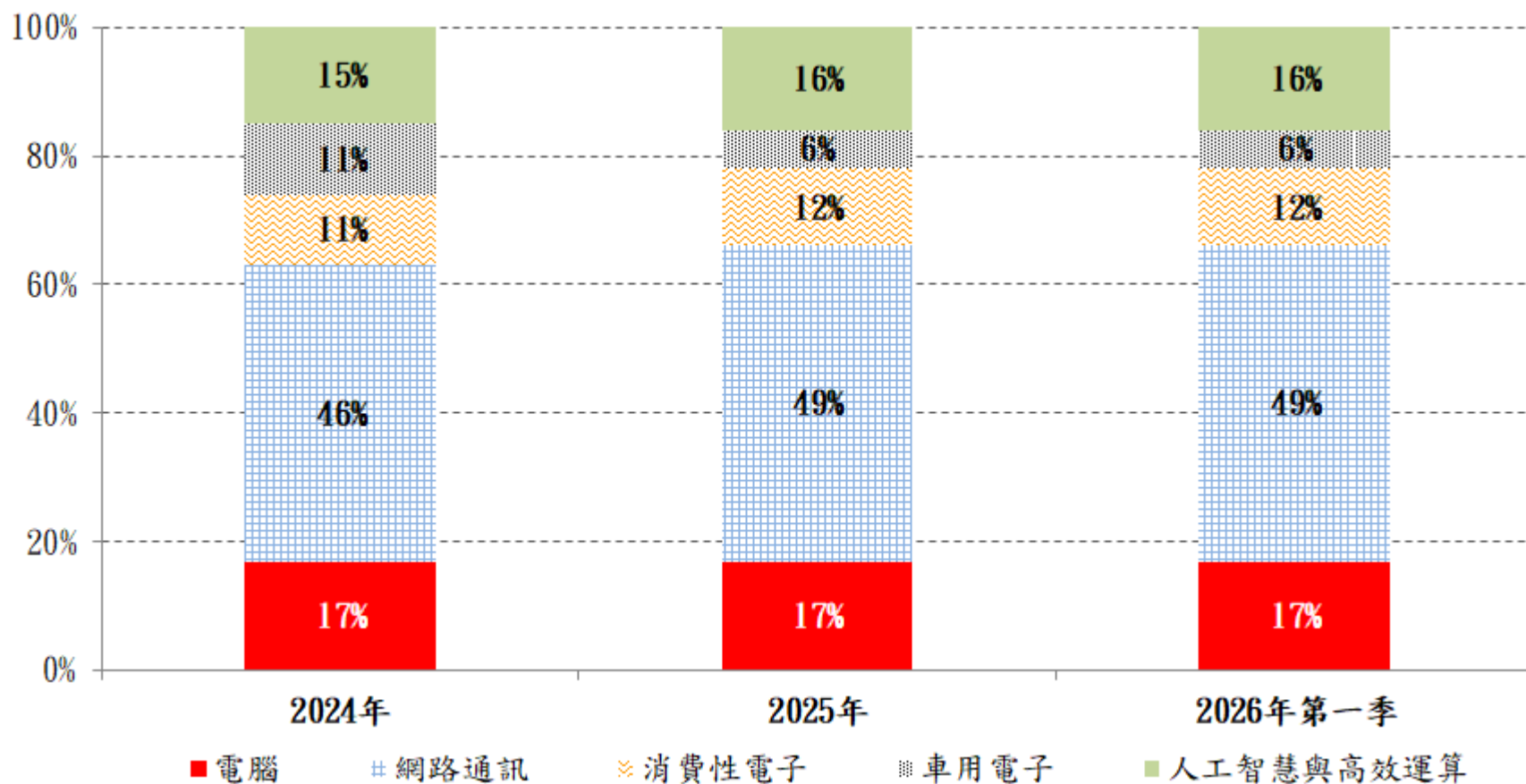


- 2025年第三季營業利益較2025年第二季增加254.2百萬元：  
資料中心與記憶體產品需求提升，第三季營業利益比第二季增加。
- 2025年第四季營業利益較2025年第三季增加342.7百萬元：  
高階伺服器、交換器需求提高，第四季營業利益比第三季增加。
- 2026年第一季營業利益較2025年第四季增加389.2百萬元：  
伺服器、交換器應用IC載板穩健成長，第一季營業利益比第四季增加。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別)

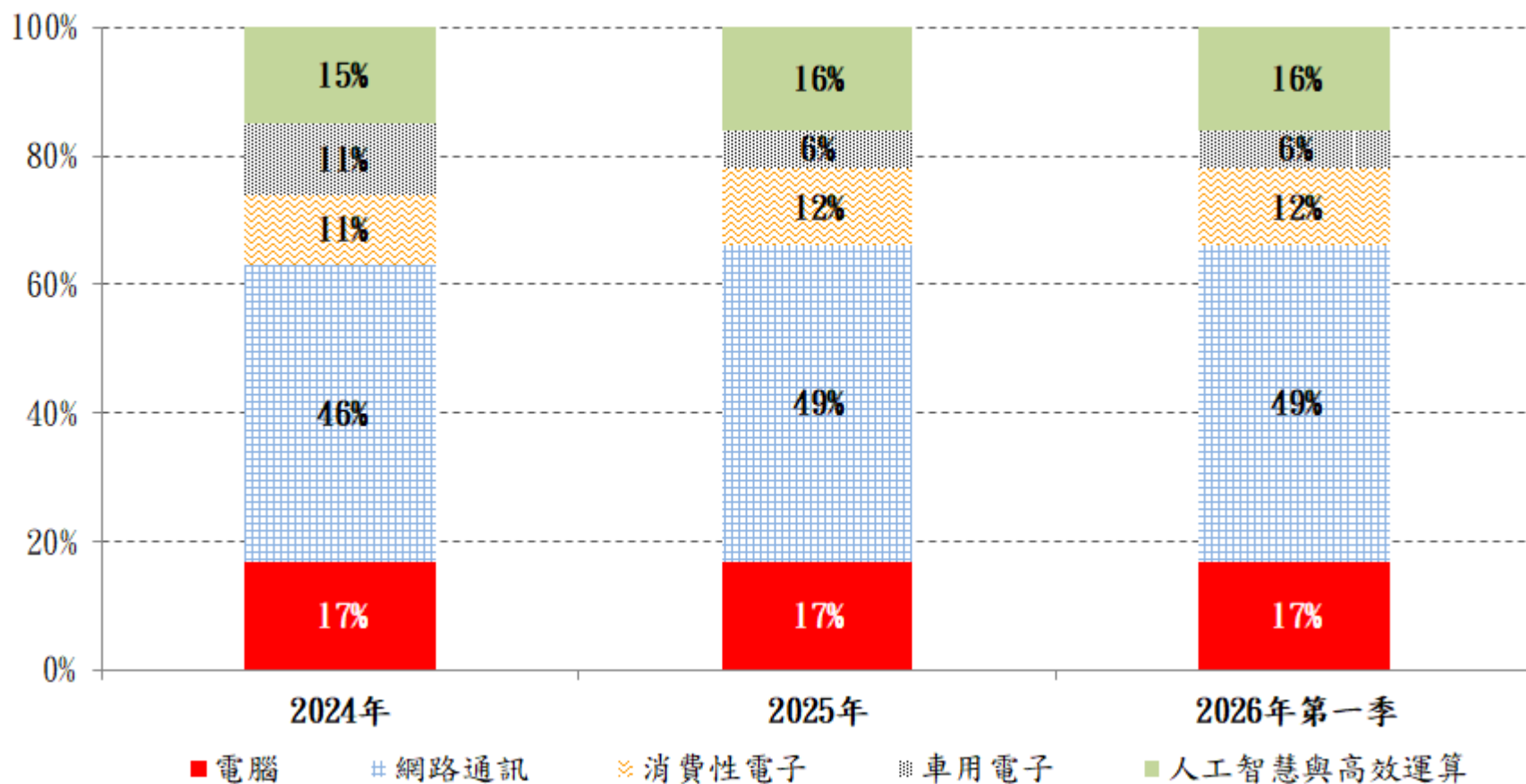


- 個人電腦與消費性電子因零組件短料，銷售量成長有限，2026年第一季本公司相關應用營收比重與2025年持平。
- 資料中心升級高階交換器趨勢不變，2026年第一季本公司網通應用產品營收比重維持高檔。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別)



- 汽車需求仍疲弱，供應鏈亦受影響，致2026年第一季本公司車用電子應用產品營收比重與2025年持平。
- 資料中心對人工智慧與高效運算需求穩健，2026年第一季應用產品比重與2025年持平。



# 產品未來發展方向

## 持續拓展高值化產品

### ■ ABF載板

大型雲端服務業者持續擴大資料中心資本支出，本公司與客戶緊密合作，開發新世代AI伺服器客製化晶片等應用載板，並因應大量資料的高速傳輸需求，開發新世代高階交換器與路由器晶片應用載板，提升高值化產品比重。

### ■ BT載板

本公司除將開發新世代行動裝置的5G天線模組、智慧眼鏡、資料中心儲存裝置及固態硬碟控制晶片等應用載板外，另隨著AI應用晶片對高功率轉換效率的電源管理模組需求，與客戶合作開發新世代伺服器及電源IC控制晶片應用載板，提升獲利。

### ■ 一般電路板

資料中心伺服器與交換器帶動高階電路板需求，本公司將開發並量產相關產品商機，如：伺服器網通卡、伺服器配板及交換器高層板；此外也針對各類邊緣AI產品商機，將量產高階PC與LED燈珠電路板，使產品更加多元化。



# 2026年營運策略

## 公司持續執行四大轉型以提升競爭力

- 產品轉型：持續提升雲端運算、邊緣運算、高速傳輸產品的銷售比重，使產品線更加高值化與多元化。
- 事業轉型：開發新材料、新技術及新產品，深化公司產業佈局。
- 數位轉型：應用數位科技，精進AI及數位轉型，實現智能化營運。
- 低碳轉型：擴大綠電使用，致力節能減碳，落實循環經濟推動。



感謝您的聆聽

